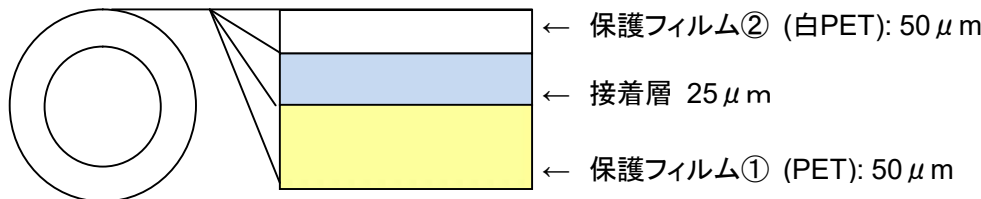


**LIOELM TSU®550**

“Lioelm TSU500”シリーズは、主に多層FPCの層間接着シートとして開発された、耐熱接着シートです。第5世代通信(5G)に対応したアンテナ、ミリ波レーダー向け多層フレキシブル基板の層間接着シートとしてご使用いただけます。低誘電で設計された接着シートのため、高周波回路で伝送損失を低減できます。硬化後、優れた耐熱性を有する製品です(260℃ 半田リフロー)

## 【構成】



## 【物性】

			単位	TSU550
接着層の厚み			μm	25
保護フィルムの厚み① (PET)			μm	50
保護フィルムの厚み② (PET)			μm	50
誘電率 28GHz				2.77
誘電正接 28GHz				0.0020
接着力	対 CU	初期	N/10cm	5 以上
		リフロー後		5 以上
耐熱性 (260℃ ピークリフロー)			—	合格

上記データは弊社テスト条件下の値であり、保証するものではありません。

## ＜接着力測定方法＞

- 構成: LCP CCL もしくは、M-PI CCL / CU/TSU / CU/ LCP CCL もしくは、M-PI CCL
- プレス条件  
90℃ラミネート⇒ 180℃×2MPa×5分プレス ⇒ 180℃×1hr ポストキュア
- 引っ張り速度: 50mm/min
- 引っ張り角度: 90°

## 【推奨プレス条件】

ラミネート条件: 90℃ 0.3 MPa 1M/mm

## プレス条件

180℃ 2~3MPa 3分以上真空クイックプレス後、ポストキュア 180℃×1時間を推奨します。

もしくは、

180℃ 2~3MPa 60分以上プレス

## 【保管条件】

10℃/ 70%RH の保冷環境下で保管して下さい。

ご使用の際は、7時間以上常温放置してご使用下さい。

2020年1月作成 2023年9月改定